

News Release



Intel Corporation
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054-1549



Tower Semiconductor Ltd.
Ramat Gabriel Industrial Park
20 Shaul Amor Ave.
P.O. Box 619
Migdal Haemek, 2310502
Israel

※本リリースは 2023 年 9 月 5 日に発表されたリリースを翻訳したものです

インテル・ファンドリ・サービスとタワーセミコンダクターが新たな米国でのファンドリ契約を発表

ニューメキシコ州にあるインテルの先端 300mm 製造施設で、タワーに新たな生産キャパシティを提供し、

将来の成長をサポート

カリフォルニア州サンタクラア、およびミグダルハエメク、イスラエル、2023 年 9 月 5 日-インテル・ファンドリ・サービス(IFS)とアナログ半導体ソリューションのリーディングファンドリであるタワーセミコンダクター(Nasdaq: TSEM)は、本日、タワーが世界中のお客様に対応するために、インテルとしてファンドリサービスと 300mm の製造キャパシティを提供することで合意したと発表しました。この契約に基づき、タワーはニューメキシコ州にあるインテルの先端の製造施設を利用します。タワーは、ニューメキシコ州の工場に設置する設備やその他の固定資産を取得・所有するために最大 3 億ドルの投資を行います。これにより、タワーの将来の成長に向け、月 600,000 枚以上のフォトレイヤーという新たなキャパシティが提供でき、300mm の高度なアナログデバイスに必要と予測される顧客需要をサポートする体制が可能になります。

この契約は、インテルとタワー両社が、他に類を見ないソリューションと規模を備えたそれぞれのファンドリファクトリーを拡大する取り組みを実証するものです。インテルは、ニューメキシコ州リオランチョにあるインテルのファブ 11X で、タワーの高度で差別化された 65nm パワー・マネジメント BCD(bipolar-CMOS-DMOS)デバイスを製造する予定です。

インテル上級副社長兼インテル・ファンドリ・サービスのゼネラルマネジャーである、Stuart Pann 氏は、次のように述べています。「当社は、インテルと当社のエコシステムを最大限に活用して安全で持続可能で回復力のあるサプライ・チェーンを結集した世界初のオープン・システム・ファクトリーを提供するという長期的な視野で、IFS を立ち上げました。私たちは、タワーが当社

の提供する独自の価値を理解し、米国の 300mm の製造キャパシティ増設のために我々を選択してくれたことを大変嬉しく思います。

タワーの CEO である Russell Ellwanger 氏は次のように述べています。「インテルとのパートナーシップを継続できることを大変嬉しく思います。将来を見据えて、最先端のテクノロジーソリューションの大規模な製造を通じてお客様とのパートナーシップを拡大することが重要な焦点になっています。このインテルとのコラボレーションにより、2024 年に計画されているフルプロセスフロアの確立ができ、特に先進的なパワーマネジメントと高周波 SOI(RF SOI)ソリューションにフォーカスしているお客様の需要ロードマップに対応することが可能となります。これは、インテルとの複数の独自のシナジーソリューションに向けた第一歩と考えています。」

この契約は、IFS が、米国、ヨーロッパ、イスラエル、アジアを含むインテルのグローバル工場ネットワーク全体の製造キャパシティへのアクセスをどのように可能にするかを示しています。インテルはオレゴンへの既存投資やオハイオ州の計画投資に加え、アリゾナ州とニューメキシコ州の拠点など、40 年以上にわたって米国南西部への投資やイノベーションを行ってきました。インテルは以前、ニューメキシコ州で事業を拡大するために 35 億ドルを投資し、最先端半導体パッケージを製造するためのイノベーションのブの一つであるリオンチョキャンパスに設備を導入すると発表していました。

タワーにとっては、業界をリードする 65nm BCD パワーマネジメント技術や RF SOI 技術など強大な市場の採用により、拡大する 300mm テクノロジー向け顧客ベースにサービスを提供するための規模拡大への次ステップです。具体的には、タワーの 65nm BCD 技術は、クラス最高のオン抵抗性能指数により、消費電力、ダイサイズ、ダイコストの改善をお客様に提供します。同様に、タワーの 65nm RF SOI 技術は、お客様のモバイル機器のバッテリー消費を削減しながら、クラス最高の RonCoff 性能指数によりワイヤレス接続性を向上させるのに役立ちます。この契約による規模の拡大は、タワーが既存技術でより大きな機会を提供できるだけでなく、業界をリードする顧客とのパートナーシップを強化し、強力な次世代テクノロジーのロードマップを構築することも可能になります。

IFS は、インテルの IDM2.0 戦略の重要な柱であり、本日の発表は、技術におけるリーダーシップ、製造規模、長期的な成長を取り戻し、強化するための、インテルの複数年にわたる変革の新たな一歩を意味します。2023 年第 2 四半期には、前年同期比 300%以上の売上増となったことからわかるように、ここ 1 年間に大きな成果をあげています。この機運は、インテルが最近 [Synopsys と合意した、インテル 3 とインテル 18A のプロセスノードにおける知的財産](#)のポートフォリオを開発することでさらに実証されます。また、Intel は [米国国防総省の Rapid Assured Microelectronics Prototypes-Commercial\(RAMP-C\)プログラム](#)を受賞し、Intel18A の設計契約に 5 社のカスタマーの RAMP-C が参加しました。

Forward-Looking Statements

This release contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties. Such statements include those regarding Intel's business plans and strategy and anticipated benefits therefrom, including with respect to its external foundry ambitions, internal foundry model, IDM 2.0 strategy, manufacturing capacity expansion plans, IP portfolio expansion and agreements with Tower and other customers. Such statements involve many risks and uncertainties that could cause Intel's actual results to differ materially from those expressed or implied, including: changes in demand for Intel's products; Intel's failure to realize the anticipated benefits of its strategy, plans, and proposed transactions; the high level of competition and rapid technological change in the semiconductor industry; the significant upfront investments in R&D and Intel's business, products, technologies, and manufacturing capabilities; the complexity and fixed cost nature of semiconductor manufacturing operations; construction delays or changes in plans due to business, economic, or other factors; increases in capital requirements and changes in capital investment plans; adverse changes in anticipated government incentives and associated approval related to Intel's planned capital investments; vulnerability to new product development and manufacturing-related risks, including product defects or errata, particularly as Intel develops next generation products and implements next generation process technologies; risks associated with a highly complex global supply chain, including from disruptions, delays, trade tensions, or shortages; sales-related risks, including customer concentration and the use of distributors and other third parties; potential security vulnerabilities in Intel products; cybersecurity and privacy risks; investment and transaction risk; IP risks and risks associated with litigation and regulatory proceedings; evolving regulatory and legal requirements across many jurisdictions; geopolitical and international trade conditions; Intel's debt obligations; risks of large scale global operations; macroeconomic conditions; impacts of the COVID-19 or similar such pandemic; and other risks and uncertainties described in Intel's earnings release dated July 27, 2023, 2022 Annual Report on Form 10-K and other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). All information in this press release reflects Intel management's views as of the date hereof, unless an earlier date is specified. Intel does not undertake, and expressly disclaims any duty, to update such statements, whether as a result of new information, new developments, or otherwise, except to the extent that disclosure may be required by law.

インテルについて

インテルは業界のリーダーとして、世界中の進歩を促すとともに生活を豊かにし、世界を変えるテクノロジーを創出しています。ムーアの法則に着想を得て、顧客企業が抱える大きな課題を解決する半導体製品を設計・製造し、その進化に向けて日々取り組んでいます。クラウド、ネットワーク、エッジ、あらゆるコンピューティング機器のインテリジェント化によりデータの価値を最大化し、ビジネスと社会をより良く変革します。インテルのイノベーションについては、newsroom.intel.com または intel.com をご覧ください。

タワーセミコンダクターについて

タワーセミコンダクター株式会社(NASDAQ:TSEM,TASE:TSEM)は、高付加価値のアナログ半導体ソリューションのファンドリリーダーとして、コンシューマー、産業機械、車載用、モバイル、インフラ、医療用、航空宇宙・防衛などの成長市場で集積回路(IC)の技術・製造プラットフォームを提供しています。タワーセミコンダクターは、長期的なパートナーシップと先端の革新的なアナログテクノロジーの提供を通じて、意義あるサステナブルインパクトを創造することに注力し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、non-imaging sensor、パワーマネジメント(BCDおよび700V)、MEMS

など、カスタマイズが可能なプロセスプラットフォームを幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインインテグレーションを提供し、IDMやファブレス企業向けにはプロセス移管サービスを提供しています。複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワーセミコンダクターはイスラエルに2か所(150mmと200mm)、米国に2か所(200mm)、TPSCoが51%の株式を保有する日本の2か所(200mmと300mm)に生産拠点があり、イタリアに設立されている300mmファブをSTと共有しています。詳細は www.towersemi.com をご覧ください。

Safe Harbor Regarding Forward-Looking Statements

This press release includes forward-looking statements, which are subject to risks and uncertainties. Actual results may vary from those projected or implied by such forward-looking statements. A complete discussion of risks and uncertainties that may affect the accuracy of forward-looking statements included in this press release or which may otherwise affect Tower's business is included under the heading "Risk Factors" in Tower's most recent filings on Forms 20-F and 6-K, as were filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC") and the Israel Securities Authority. Tower does not intend to update, and expressly disclaim any obligation to update, the information contained in this release.

© Intel Corporation. Intel, the Intel logo and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. Other names and brands may be claimed as the property of others.

CONTACTS: Michael Anderson
Intel Investor Relations
1-916-356-7704
michael.anderson@intel.com

John Hipsher
Intel Media Relations
1-669-223-2416
john.hipsher@intel.com

Noit Levy
Tower Investor Relations
+972-4-604-7066
noitle@towersemi.com

Orit Shahar
Tower Media Relations
+972-74-7377440
oritsha@towersemi.com